

台亞半導體

2026 年法人說明會

Sensing the Future.
Powering the Next.

2026.10.14



免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述係基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響，因此實際結果可能明顯不同於表述內容。

除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

投資人應依公開資訊與自身風險評估進行判斷。

大綱

01 集團公司概況與營收成果

2026 營收成長、產品組合

02 策略與展望

未來技術藍圖與商業化

03 HUSD 研發進度與計畫

研發概況與市場規畫

From Sensing to Intelligence

集團公司概況 / 營收成果

從單一光電元件，走向多元化科技集團



TASC 台亞半導體

集團母公司，感測 / 發射元件與化合物半導體策略布局



SAVC 星亞視覺

數位顯示系統、戶外看板系統與戶外視覺系統整合



NSTC 和亞智慧

AOI 設備 & AI 智慧自動化檢測整合方案



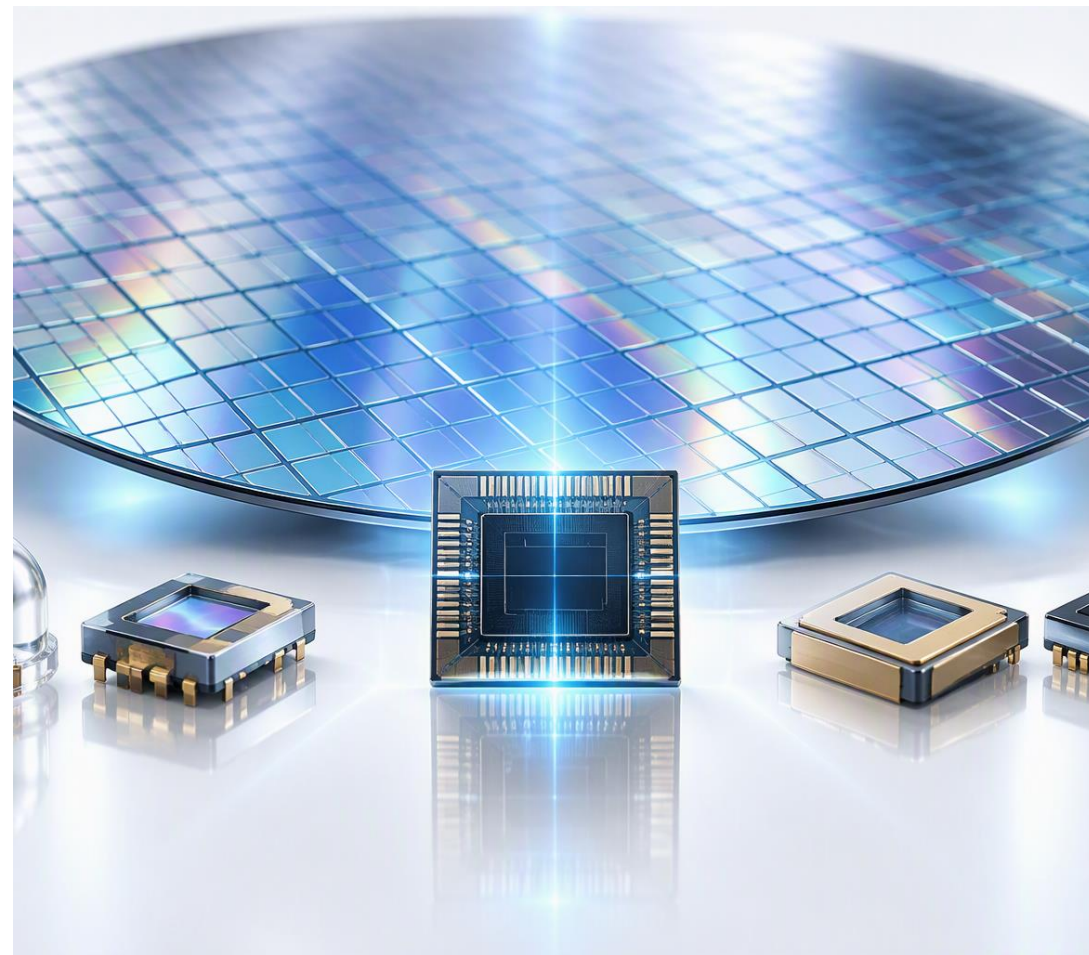
PASC 積亞半導體

SiC碳化矽功率元件晶片研發與晶圓製造（6吋晶圓產線）



CASC 冠亞半導體

GaN 氮化鎵功率元件與高壓高頻半導體產品設計研發



營收持續成長，朝向多元佈局

2026 H1 總營收

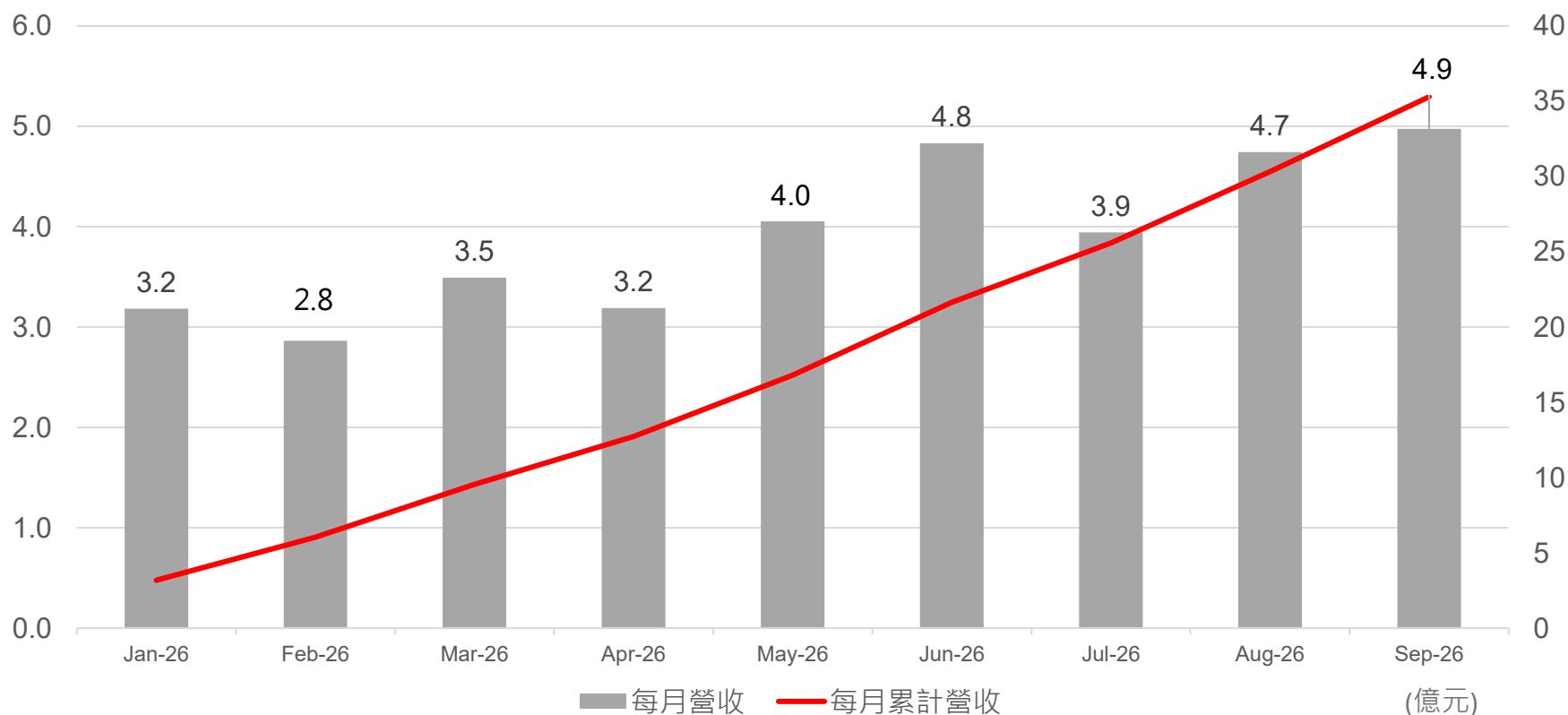
年增率

21.6 億元 +2.2%

2026 年 1-9 月合併營收

年增率

35 億元 +8.16%



台亞集團策略及未來展望

經營策略: 穩固本業，奠定新事業基石

CURRENT ENGINE

鞏固本業發展

感測與發射元件

系統事業與顯示應用

製造能力與客戶基礎



NEXT ENGINE

創造未來成長機會

SWIR / eSWIR

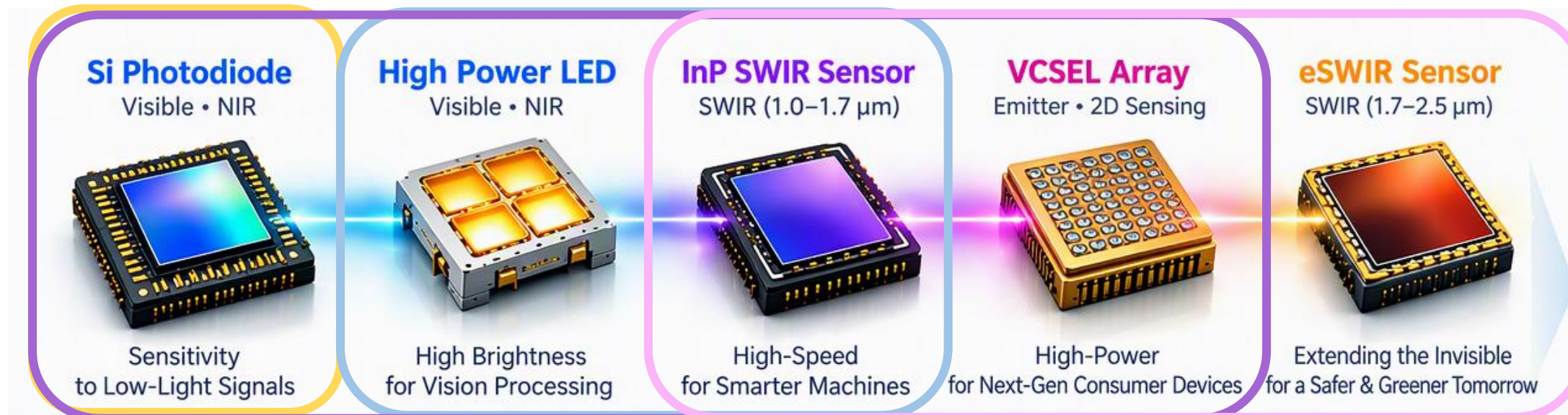
HUSD 健康感測

AI Vision / AOI

SiC / GaN 功率元件

以本業技術、製造與客戶基礎，建立下一條成長曲線。

台亞技術開發藍圖 & 市場應用



2024 - 2027

2028 - 2030



AI伺服器元件



感測應用(HUSD / NIUM)



光通訊(可見光)



光通訊(高速)



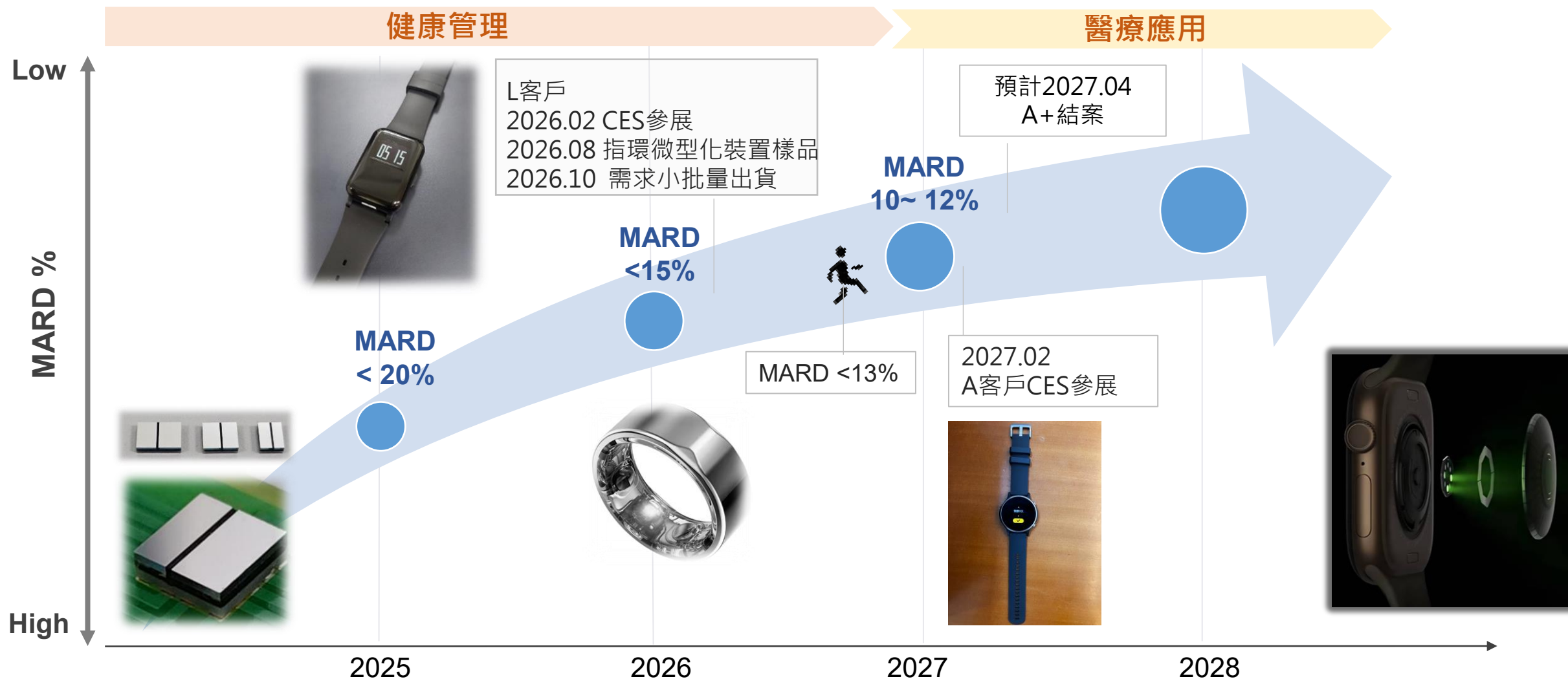
車載領域

應用領域

HUSD(非侵入連續血糖監測)研發進度計畫

HUSD 研發成果

2026持續精度提升 → 目標 2027 MARD <12%



從元件、模組、演算法，垂直整合

01 Optical Chip

多波長光源與感測

02 Sensor Module

微型化與光路整合

03 Firmware + ML

特徵擷取與趨勢演算法

04 Health Application

穿戴、健康管理、醫療合作



台亞精神貫徹投資人承諾 — 努力學習、勤於思考、用心工作、創造世界第一的商品

01	客戶服務	品質、可靠度、回應速度	穩定營收與黏著
02	營運效率	優化製程能力、良率、成本	增加毛利、提升競爭力
03	自主開發	磊晶、晶片、演算法、模組	強化技術門檻
04	產品創新	新產品與應用開發	擴大市場版圖
05	多元發展	GaN / SiC / SWIR / HUSD / NIUM	降低營運風險



We build what the future needs.

以感測看見需求，用科技創造下一個成長。

FOCUS

EXECUTE

SCALE